



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

20th

April 2022 (Wednesday) / 2022 年 4 月 20 日(星期三)

(CE22-TC1) Technology Conference / 高科技技术研讨会

Conference Chairman/会议主席:

Yunhong Yu 余允红

Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员

Great China ALTEC ECP Application Manager and WBL ECP Market Leader of Air Liquide (China) Holding Co., Ltd.

液化空气(中国)投资有限公司大中华电子元器件和产品应用技术经理和全球电子元器件和产品市场经理

Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:45 – 11:20	Ultra-Low-Residue Flux Application In RF Front End Packaging 超低残留助焊剂在射频前端芯片封装中的应用 (CE22-TC1.1)	Leo Hu 胡彦杰 Indium Corporation 钢泰公司
11:20 – 11:55	High-Reliability Lead-free Solders for Automotive Electronics - Thermal Cycling and Shear Strength Performance 用于汽车电子的高可靠性无铅焊料 - 热循环和剪切强度性能 (CE22-TC1.2)	William Yu 余瑜 MacDermid Alpha Electronics Solutions 麦德美爱法
11:55 – 12:30	Engineered Aqueous Cleaning: It All Comes Down To Performance 精密水基清洗: 追求最终的性能与成果 (CE22-TC1.3)	Daniel Gao 高伟 Shanghai KYZEN Cleaning Materials Co., Ltd. 上海凯晟清洁材料有限公司
12:30– 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Selective Soldering With High-Performance Lead-Free Solders 使用高性能无铅焊料进行选择性的焊接 (CE22-TC1.4)	Kar Heong Khoh 许教雄 ITW EAE 苏州依工电子设备有限公司
14:20 - 14:55	LIT-TPT-SEMI: Ultrafine Solder Paste Dispensing for Heterogeneous Integration 99841 R0 (NT) 超细粉末点涂锡膏在异构集成中的挑战和应用 (CE22-TC1.5)	Joey Qiao 乔广浩 Indium Corporation 钢泰公司
14:55 - 15:30	Low-Temperature Solders SMT Process Optimization for Enhanced Reliability 优化低温焊接表面贴装技术(SMT) 工艺优化, 提高可靠性 (CE22-TC1.6)	William Yu 余瑜 MacDermid Alpha Electronics Solutions 麦德美爱法

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

21st April 2022 (Thursday) / 2022 年 4 月 21 日(星期四)

(CE22-TC2) Technology Conference / 高科技技术研讨会

Conference Chairman/会议主席:

Lin Dong 董林

Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员

Senior Manager, Advanced Manufacturing Engineering of Artesyn Embedded Technologies

雅特生科技有限公司先进制造工程高级经理

Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:45 – 11:20	How To Solve LGA Voiding Through Process Optimization 如何通过工艺优化解决 LGA 空洞 (CE22-TC2.1)	Wisdom Qu 瞿艳红 Indium Corporation 钢泰公司
11:20 – 11:55	Addressing Concerns of Ultra-Miniature Component Assembly In 2022: M0201, 008005 and Micro/MiniLEDs 2022 年超微型元器件组装问题的解决方案: M0201、008005 和 Micro/MiniLED (CE22-TC2.2)	Dillon Zhu 朱军桦 AIM Solder
11:55 – 12:30	Cyanide Free Immersion Gold As Sustainable Solution for High Reliability ENIG Finishes 无氰浸金是高可靠性 ENIG 工艺的可持续解决方案 (CE22-TC2.3)	Leo Huang 黄春雷 Amazon 亚马逊
12:30– 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Flux Selection for Low Temperature Through-Hole Soldering Process 用於低温通孔焊接工艺助焊剂的选择 (CE22-TC2.4)	Annie Yang 杨莉 MacDermid Alpha Electronics Solutions 麦德美爱法
14:20 - 14:55	Using Big Data To Boost Agility, Reduce Costs and Accelerate NPIs 利用大数据提高敏捷性, 降低成本和加速 NPIs (CE22-TC2.5)	Shawn Pan 潘辉 Mentor 明导上海电子有限公司
14:55 – 15:30	cLIT-TPT-PCB: Fine Powder Investigation for Optimum Imperial 008004 SP Printing: Part I 99832 R0 (NT) 超细粉径锡膏在 008004 元件印刷中的研究 (CE22-TC2.6)	Leon Rao 饶乐 Indium Corporation 钢泰公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文